

LPZINC・LPZINC-S series

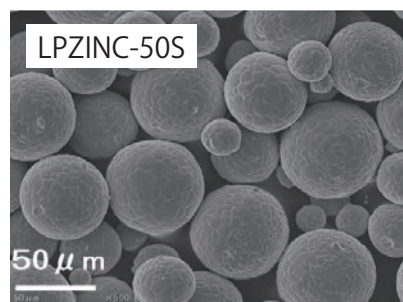
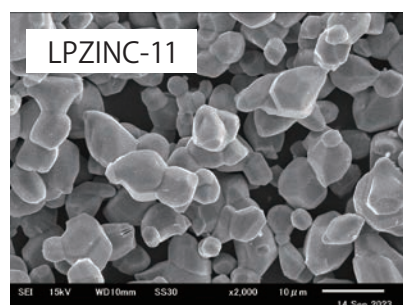
特 徴

- ◆ 各種樹脂への高密度充填により飛躍的に熱伝導率を向上。
- ◆ 物質固有の柔らかさにより接触熱抵抗を低減。
混錬機部材を摩耗しない。
- ◆ 高放熱ペースト用途で複数の採用実績あり。

物 性

	LPZINC series	LPZINC-S series	LPZINC-KS/-HS series
品 番	LPZINC-2, -5, -11, -20	LPZINC-6S, -10S, -20S, -30S, -50S	LPZINC-2-KS、-20S-KS 他 LPZINC-2-HS、-20S-HS 他
粒子径 (μm)	2, 5, 11, 20	6, 10, 20, 40, 70	2, 5, 11, 20, 40, 70
特 長	<u>標準グレード</u> 粗粒低減により薄膜用途に最適(D100<50 μm)	<u>球状グレード</u> 樹脂への充填性及び流動性UP	<u>表面処理*グレード</u> 樹脂親和性を向上 KS:シリコン処理 HS:シラン処理

*他にも有機・無機表面処理品のラインナップがございます



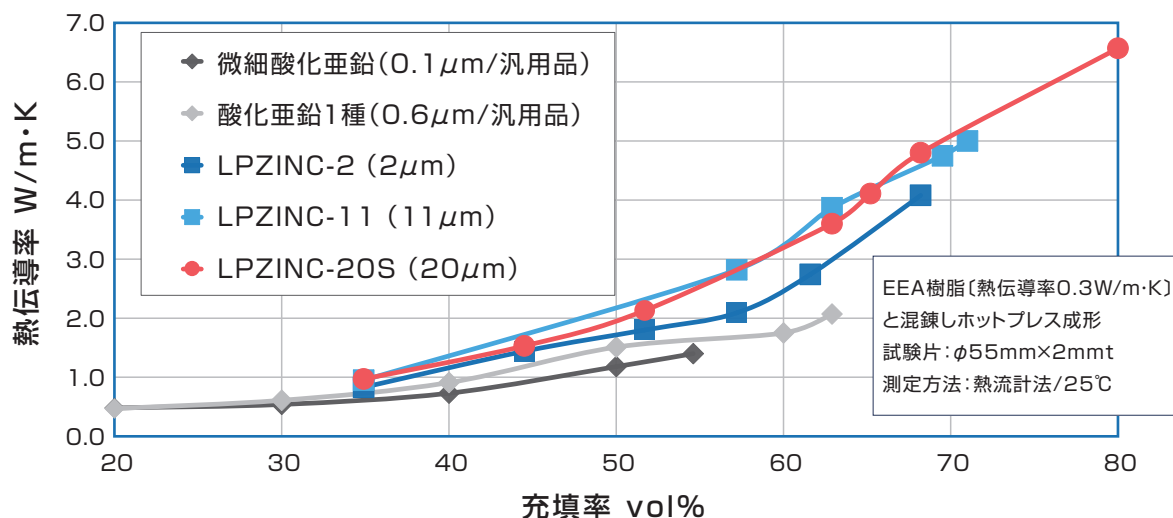
シリーズ	グレード	粒子径 (μm)	D10 (μm)	D50 (μm)	D90 (μm)
LPZINC	LPZINC-2	2	0.7	2.0	4.1
	LPZINC-5	5	1.8	4.1	7.3
	LPZINC-11	11	7.4	11.5	18.8
	LPZINC-20	20	9.4	20.8	35.1
LPZINC-S	LPZINC-6S	6	4.0	6.2	10.1
	LPZINC-10S	10	5.8	10.1	18.1
	LPZINC-20S	20	16.1	27.0	45.3
	LPZINC-30S	40	26.8	41.2	64.0
	LPZINC-50S	70	43.0	68.4	113.0

※粒度分布は代表分析値。装置:MT3300EX II (Nikkiso製)測定方法:レーザー回折・散乱法



熱伝導率評価

◆ 単体使用時



サブミクロン粒子の充填限界

大粒子化・球状化による高密度充填

◆ 併用時 (最密充填効果)

	球状大粒子酸化亜鉛 LPZINC-30S	LPZINC 混合配合
粒子外観		体積比 LPZINC-30S /LPZINC-11 /LPZINC-2 =63/4.8/2.2vol%
シート断面		
フィラー充填率	63vol%	70vol%
熱伝導率	2.9W/mK	6.5W/mK

大粒子と小粒子の併用により 更に放熱性能向上!



堺化学工業株式会社

SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

営業本部 無機材料営業部

TEL: 東京 03-5823-3722 大阪 072-223-4155

E-mail: sales-t@sakai-chem.co.jp

https://www.sakai-chem.co.jp

マスコットキャラクター
チータン

2024.01.17